# IIA

FLAME-RETARDANT	AROMATIC	<b>POLYAMIDE</b>	RESIN	COMPOSITION	AND	MOI DED
OBJECT					,	
ODJECI						

Patent Number:

EP1164170

Publication date:

2001-12-19

Inventor(s):

KAMESHIMA TAKASHI (JP); NAKANO SHINJI (JP); TADA YUJI (JP); NISHIOKA YOICHI (JP); TAKASE

HIROYUKI (JP); YABUHARA TADAO (JP)

Applicant(s):

OTSUKA CHEMICAL CO LTD (JP)

Requested

Patent:

☐ JP2001131409

Application

Number:

EP20000971824 20001107

**Priority Number** 

(s):

WO2000JP07812 20001107; JP19990317880 19991109

**IPC** 

Classification:

C08L77/10; C08L85/02; C08J5/00; C08K5/5399; C08K7/04; C08K3/22

Cited patent(s):

EC Classification: C08K7/04, C08L77/10, C08K3/22, C08K5/5399, C08K7/02, C08L85/02

Equivalents:

AU1057701, JP3122818B2, ☐ <u>US6521689</u>, ☐ <u>WO0134704</u>

EP0881264; US4094856; WO0009518

#### Abstract

An object of this invention is to impart excellent flame retardancy to an aromatic polyamide resin without use of a halogen compound which is responsible for generation of gases harmful to the human body and without decreasing preferred properties (e.g. mechanical properties, and molding processability) inherently possessed by aromatic polyamide resins, the flame-retardant aromatic polyamide resin composition of this invention comprising (a) 100 parts by weight of an aromatic polyamide resin, (b) 0.1 to 100 parts by weight of a crosslinked phosphazene compound which is a compound crosslinked with a crosslinking group, such as phenylene groups, the crosslinking group being interposed between the two oxygen atoms left after the elimination of phenyl groups from the phosphazene compound, no free hydroxyl group being present in the molecule, the amount of all phenyl groups in the crosslinked compound being 50 to 99.9% based on the total amount of the phenyl groups in the phosphazene compounds, (c) 1 to 60 parts by weight of an inorganic fibrous substance and (d) 1 to 60 parts by weight of magnesium hydroxide.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-131409 (P2001-131409A)

(43)公開日 平成13年5月15日(2001.5.15)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I - デーマコート*( <del>多考</del>	) ·
CO8L 77/1	0	C08L 77/10 4J002	
C08K 5/5	5399	C 0 8 K 5/5399	
7/0	02	7/02	
// (CO8L 77/	′10	(C 0 8 L 77/10	
85: 0	02)	85: 02)	
		審査請求 有 請求項の数3 OL (全 14 )	頁)
(21)出願番号	<b>特願平11-317880</b>	(71) 出願人 000206901	
		大塚化学株式会社	
(22)出顧日	平成11年11月9日(1999.11.9)	大阪府大阪市中央区大手通3丁目2番2	7号
		(72)発明者 薮原 忠男	
		徳島県徳島市一宮町西丁166	
		(72)発明者 多田 祐二	
	•	徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚	1L
•		学株式会社徳島研究所内	
		(72)発明者 中野 真司	
•		徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚	E
		学株式会社徳島研究所内	
		(74)代理人 100065215	
•		弁理士 三枝 英二 (外8名)	
. •		最終頁に	谠く

# (54) 【発明の名称】 難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物

# (57)【要約】

【課題】 人体に有害なガス発生の原因となるハロゲン 化合物を用いることなく、また芳香族ポリアミド樹脂が 本来有する好ましい特性(機械特性、成形加工性等)を 損なうことなく、芳香族ポリアミド樹脂に優れた難燃性 を付与することを課題とする。

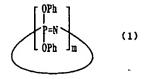
【解決手段】 (a) 芳香族ポリアミド樹脂100重量 部に、(b) 架橋ホスファゼン化合物0.1~100重 量部、(c) 無機繊維状物質1~60重量部及び(d) 水酸化マグネシウム1~60重量部を配合してなる難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 芳香族ポリアミド樹脂100重量部に、(b) 架橋ホスファゼン化合物0.1~100重量部、(c) 無機繊維状物質1~60重量部及び(d) 水酸化マグネシウム1~60重量部を配合してなる難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物。

【請求項2】 (b)成分の架橋ホスファゼン化合物が、一般式(1)

【化1】



〔式中mは3~25の整数を示す。Phはフェニル基を示す。〕で表される環状フェノキシホスファゼン及び一般式(2)

【化2】

$$X^{1} = \begin{cases} 0^{Ph} \\ P=N \\ 0^{Ph} \end{cases} Y^{1} \qquad (2)$$

「式中 $X^1$ は基 $-N=P(OPh)_3$ 又は基-N=P(O)OPhを示し、 $Y^1$ は基 $-P(OPh)_4$ 又は基 $-P(O)(OPh)_2$ を示す。nは3 $\sim$ 1000の整数を示す。Phは前記に同じ。〕で表される鎖状フェノキシホスファゼンからなる群より選ばれる少なくとも1種のホスファゼン化合物が、O-フェニレン基、M-フェニレン基及M-の元 (3)

【化3】

〔式中Aは $-C(CH_3)_2-$ 、 $-SO_2-$ 、-S-又は-O-を示す。aはO又は1を示す。]で表されるビスフェニレン基からなる群より選ばれる少なくとも1種の架橋基により架橋されてなる化合物であって、(i) 該架橋基はホスファゼン化合物のフェニル基が脱離した2個の酸素原子間に介在し、(ii) フェニル基の含有割合が上記ホスファゼン化合物(1)及び/又は(2)中の全フェニル基の総数を基準に5O-99.9%であり、且つ(iii)分子内にフリーの水酸基を有していない架橋フェノキシホスファゼン化合物である請求項1に記載の難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物。

【請求項3】 無機繊維状物質が、繊維状チタン酸アルカリ金属塩、繊維状ホウ酸遷移金属塩、繊維状ホウ酸アルカリ土類金属塩、繊維状酸化亜鉛、繊維状酸化チタン、繊維状酸化マグネシウム、繊維状石膏、繊維状珪酸アルミニウム、繊維状珪酸カルシウム、繊維状炭化珪素、繊維状炭化チタン、繊維状窒化珪素、繊維状炭化チタン、炭素繊維、アルミナ繊維、アルミナーシリカ繊

雑、ジルコニア繊維、ガラス繊維及び石英繊維から選ばれる少なくとも1種である請求項1に記載の難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1~請求項3に記載の難燃性ポリアミド樹脂組成物を成形して得ることのできる難燃性芳香族ポリアミド樹脂成形体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は難燃性芳香族ポリア ミド樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】芳香族ポリアミド樹脂は、耐熱性、機械特性、成形加工性、耐薬品性等に優れ、自動車部品、電気・電子部品、機械部品等として広く使用されている。これらの用途では、発熱による発火等を防止するために、芳香族ポリアミド樹脂に難燃剤を配合して該樹脂を難燃化することが必要となる。とりわけ、電気・電子部品用途では、UL規格(Underwriters Laboratories, Inc., Standard for Tests for Flammability of Plastic Materials)でV-0(燃焼が一定時間以上継続せず、綿を発火させる溶融滴下(ドリップ)がない)という特に高い難燃性が要求される。

【0003】芳香族ポリアミド樹脂に難燃剤を配合した 難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物としては、今日まで 種々の提案がなされており、例えば、芳香族ポリアミド 樹脂に臭素化ポリスチレンと酸化アンチモンとを配合し た組成物 (特開平6-263985号公報、特開平6-263986号公報)、芳香族ポリアミド樹脂に臭素化 ポリスチレンと水酸化マグネシウム等とを配合した組成 物(特開平7-196875号公報)、芳香族ポリアミ ド樹脂にハロゲン置換されたホスファゼン化合物を配合 した組成物 (特開昭49-133470号公報、特開昭 49-132149号公報) 等を挙げることができる。 【0004】しかしながら、これらの組成物に難燃剤と して配合されているハロゲン化合物は、樹脂成形時に熱 分解してハロゲン化水素を発生し、金型の腐食や樹脂の 劣化及び着色を惹起するを避け得ない。また、火災等に より樹脂成形物が燃焼する際にはハロゲン化水素等の生 物に対する有害ガスや煙を発生するという問題点を有し ている。

【0005】一方、ハロゲン化合物を含まない難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物としては、例えば、芳香族ポリアミド樹脂に無機充填剤、赤燐、メラミンシアメレート等を配合した組成物(特開昭55-161848号公報)、芳香族ポリアミド樹脂にフェノール樹脂、アルデヒド樹脂、赤燐、充填剤等を配合した組成物(特開昭54-25956号公報、特開昭54-80357号公報)等が知られている。

【0006】しかしながら、これらの組成物は、いずれ も赤燐を含有しているため、該組成物を成形して得られ る成形体が著しく着色するのを避け得ず、上記用途に使用し難くなるという問題点を有している。また、特開平9-183864号公報には、芳香族ポリアミド樹脂にホスホリルアミド系化合物、シアヌル酸等を配合した組成物が開示されている。この組成物は、ハロゲン化合物及び赤燐のいずれも含有していないが、該組成物を成形して得られる成形体の難燃性及び機械特性は十分満足できるものではない。

【0007】更に、ハロゲンを含有しないリン酸エステ ル化合物が、熱可塑性樹脂の難燃剤として汎用されてお り、斯かるリン酸エステル化合物が配合された難燃性樹 脂組成物も数多く提案されている。ここでハロゲンを含 有しないリン酸エステル化合物としては、例えばレゾル シノールーピス(ジフェニルホスフェート)、ハイドロ キノンービス (ジフェニルホスフェート)、ビスフェノ ール-A-ビス (ジフェニルホスフェート)、ビスフェ ノールーSービス (ジフェニルホスフェート)、レゾル シノールービス (ジキシリルホスフェート)、ハイドロ キノンービス (ジキシリルホスフェート)、ビスフェノ ール-A-ビス (ジトリルホスフェート)、ビスフェノ ール-A-ビス(ジキシリルホスフェート)、ビスフェ ノールーS-ビス (ジキシリルホスフェート) 等が知ら れている。しかしながら、これらのリン酸エステル化合 物を配合した場合には、樹脂成形物が燃焼する際に、樹 脂が溶融滴下 (ドリップ) するのを十分に防止すること はできない。従って、これらのリン酸エステル化合物を 樹脂に配合しても、UL-94規格のV-0に適合する 難燃性樹脂組成物及び成形体を得ることはできない。

# [0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、人体に有害なガス発生の原因となるハロゲン化合物を用いることなく、また芳香族ポリアミド樹脂が本来有する好ましい特性(機械特性、成形加工性等)を損なうことなく、芳香族ポリアミド樹脂に優れた難燃性を付与することを課題とする。

#### [0009]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意研究を行った結果、芳香族ポリアミド樹脂に下記に示す特待の化合物を特定割合で配合した場合に、所望の難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物が得られることを見い出した。本発明は、斯かる知見に基づき完成されたものである。

【0010】本発明によれば、(a) 芳香族ポリアミド 樹脂100重量部に、(b) 架橋ホスファゼン化合物 0.1~100重量部、(c) 無機繊維状物質1~60重量部及び(d) 水酸化マグネシウム1~60重量部を配合してなる難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物が提供される。

【0011】また、本発明によれば、上記難燃性ポリア ミド樹脂組成物を成形して得ることのできる難燃性芳香 族ポリアミド樹脂成形体が提供される。

【0012】本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物は、下記に示す多くの利点を有している。

【0013】(1) 本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂 組成物はハロゲン化合物を含有せず、従って樹脂成形時 にハロゲン化合物が熱分解してハロゲン化水素等を発生 し、金型の腐食や樹脂の劣化及び着色を惹起することは ない。

【0014】(2) 火災等により本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂成形物が燃焼する際にはハロゲン化水素等の生物に対する有害ガスや煙を発生することがない。

【0015】(3) 本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂 組成物及び成形体は、UL規格のV-0に相当する優れ た難燃性を備えている。

【0016】(4) 本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂 成形体が燃焼する際に、樹脂が溶融滴下することがない。即ち、本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂成形体 は、燃焼時のドリップ防止性を備えている。

【0017】(5) 本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂 成形体は、芳香族ポリアミド樹脂が本来有している機械 特性、成形加工性等の好ましい特性が損なわれることな く、そのまま保持している。

#### [0018]

【発明の実施の形態】本発明の難燃性芳香族ポリアミド 樹脂組成物は、芳香族ポリアミド樹脂、架橋ホスファゼ ン化合物、無機繊維状物質及び水酸化マグネシウムを必 須成分として含有する。

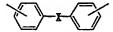
### 【0019】芳香族ポリアミド樹脂

本発明において、芳香族ポリアミド樹脂としては、2価の芳香族環残基及び2価の複素環残基から選ばれる2価残基とアミド残基(-CONH-)とが結合してなる繰り返し単位を主鎖中に含有するものであれば特に制限されず、従来公知のものをいずれも使用できる。

【0020】ここで2価の芳香族残基としては、例えば、フェニレン基、アルキレンフェニレン基、ジアルキレンフェニレン基、ビフェニレン基、一般式

[0021]

【化4】



【0022】〔式中Xは炭素数1~5のアルキレン基、酸素原子、硫黄原子、基-CO-又は基-SO2-を示す。〕で表される基、ナフタレン基等を挙げることができる。また、2価の複素環残基としては、例えば、2価のチアゾール残基、2価のベンゾイミダゾール残基等を挙げることができる。これらの2価残基の芳香族環又は複素環上には、ニトロ基、ヒドロキシ基、カルボキシ基、アルコキシ基等の1種又は2種以上が置換していてもよい。

【0023】2価の芳香族環残基とアミド残基とが結合

してなる繰り返し単位を主鎖中に含有する芳香族ポリアミド樹脂としては、例えば、ポリアミドMXD6樹脂、変性ナイロン6下樹脂、ポリフェニレンイソフタルアミド、ポリフェニレンテレフタルアミド、ポリベンズアミド、ポリアミドイミド、ポリアミドイミド、ポリアミド、ポリアミドイミドエステル等を挙げることができる。

【0024】2価の複素環残基とアミド残基とが結合してなる繰り返し単位を主鎖中に含有する芳香族ポリアミド樹脂としては、例えば、ポリアミドベンズイミダゾール、ポリチアゾールアミド等を挙げることができる。
【0025】これらの芳香族ポリアミド樹脂の中でも、2価の芳香族残基とアミド残基とが結合してなる繰り返し単位を主鎖中に含有する芳香族ポリアミド樹脂が好ましく、更に、テレフタル酸、イソフタル酸等の二塩基酸とヘキサメチレンジアミン、4,4'ージアミノジフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミンをのジアミンとからなる主鎖を有する芳香族ポリアミド樹脂、アジピン酸、セバシン酸等の二塩基レイ・ロジアミノジフェニルメタン、pーフェニレンジアミン、mーフェニレンジアミン等のジアミンとからなる主鎖を有する芳香族ポリアミド樹脂等が特に好ましてなる主鎖を有する芳香族ポリアミド樹脂等が特に好まし

【0026】芳香族ポリアミド樹脂は、-CONH-以外に、<math>-CO-、-OCO-、 $-SO_2-$ 、-NH-CO-0-CO-NH-、 $-CH_2-$ 等の結合単位を含んでいるものであってもよい。本発明では、これら結合単位の総量の10モル%以上が-CONH-である芳香族ポリアミド樹脂を好ましく使用できる。

11

【0027】本発明で使用する芳香族ポリアミド樹脂は、例えば、「高分子合成の実験法、大津隆行・木下雅悦著、(株)化学同人、1988年3月15日発行」第309~330頁、「重縮合と重付加、高分子学会高分子実験学編集委員会編、共立出版(株)、昭和55年8月15日発行」第83~103頁、「第4版実験化学講座・第28巻、(社)日本化学会編、丸善(株)、平成4年5月6日発行」第252~287頁、特公昭35-14399号公報、特公昭35-13247号公報、特公昭47-10863号公報、特公昭42-15637号公報その他の多数の公知文献に記載の方法により容易に製造される。

【0028】本発明では、芳香族ポリアミド樹脂に他の 樹脂を混合することができる。このような樹脂の具体例 としては、例えば、ポリアミド6、ポリアミド6,6、 ポリアミド6,12、ポリアミド4,6等の脂肪族ポリ アミド、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリイソプレ ン、ポリブタジエン等のポリオレフィン、変性ポリオレ フィン、アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン樹 脂、アクリロニトリル・スチレン樹脂、スチレン・マレ イン酸共重合体、スチレン・マレイン酸・アクリロニト リル共重合体、ボリフェニレンエーテル、変性ポリフェニレンエーテル、ポリアリレート、ボリカーボネート、液晶ポリマー、ポリテトラフルオロエチレン等を挙げることができる。芳香族ポリアミド樹脂と他の樹脂との混合割合は特に制限されず、該樹脂の芳香族ポリアミド樹脂に対する相溶性、混合して得られる樹脂組成物の用途等の各種条件に応じて適宜選択できるが、通常は芳香族ポリアミド樹脂100重量部に対して他の樹脂を200重量部以下、好ましくは100重量部以下、より好ましくは50重量部以下とすればよい。

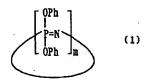
【0029】架橋ホスファゼン化合物

本発明では、ホスファゼン化合物として架橋ホスファゼン化合物を使用する。

【0030】架橋ホスファゼン化合物としては、例えば一般式(1)

[0.031]

【化5】



【0032】〔式中mは3~25の整数を示す。Phはフェニル基を示す。〕で表される環状フェノキシホスファゼン及び一般式(2)

[0033]

【化6】

$$X^{1} = \begin{cases} OPh \\ P=N \\ OPh \end{cases} Y^{1}$$
 (2)

【0034】〔式中 $X^1$ は基 $-N=P(OPh)_3$ 又は基-N=P(O)OPhを示し、 $Y^1$ は基 $-P(OPh)_4$ 又は基 $-P(O)(OPh)_2$ を示す。nは3 $\sim$ 1000の整数を示す。Phは前記に同じ。〕で表される鎖状フェノキシホスファゼンからなる群より選ばれる少なくとも1種のホスファゼン化合物が、O-フェニレン基、M-フェニレン基、M-フェニレン基、M-フェニレン基、M-

[0035]

【化7】

【0036】(式中Aは-C( $CH_3$ ) $_2-$ 、-SO $_2-$ 、-S-又は-O-を示す。aは0又は1を示す。〕で表されるビスフェニレン基からなる群より選ばれる少なくとも1種の架橋基により架橋されてなる化合物であって、(i)該架橋基はホスファゼン化合物のフェニル基が脱離した2個の酸素原子間に介在し、(ii)フェニル基の含有割合が上記ホスファゼン化合物(1)及び/又は(2)中の全フェニル基の総数を基準に50

~99.9%であり、且つ(iii)分子内にフリーの水酸基を有していない架橋フェノキシホスファゼン化合物等を挙げることができる。

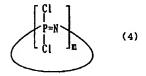
【0037】上記架橋フェノキシホスファゼン化合物は、(i)~(iii)の特徴を有することから、従来のフェノキシホスファゼン化合物よりも一段と優れた難燃性を芳香族ポリアミド樹脂に付与することができる。

【0038】上記架橋フェノキシホスファゼン化合物の中でも、一般式(1)においてmが3~8の環状フェノキシホスファゼン及び/又は一般式(2)においてnが 1000~5000の整数である鎖状フェノキシホスファゼンであり、一般式(3)においてa=1、Aが基一 $C(CH_3)_2$  一、基 $SO_2$  一及び基S 一から選ばれる少なくとも1種であるビフェニレン基である架橋フェノキシホスファゼン化合物が特に好ましい。

【0039】上記架橋フェノキシホスファゼン化合物は、例えば、一般式(4)

[0040]

[化8]



【0041】 〔式中mは前記に同じ。〕で表される環状 ジクロルホスファゼン及び一般式(5)

[0042]

【化9】

【0043】〔式中 $X^2$ は基 $-N=PC1_3$ 又は基-N=P(0)C1を示し、 $Y^2$ は基 $-PC1_4$ 又は基 $-P(0)C1_2$ を示す。nは前記に同じ。〕で表される鎖状ジクロルホスファゼンからなる群より選ばれる少なくとも1種のジクロルホスファゼン化合物に、一般式(6)

[0044]

【化10】

【0045】〔式中Mはアルカリ金属を示す。〕で表されるアルカリ金属フェノラートと、一般式(7)

[0046]

【化11】

【0047】〔式中Mは前記に同じ。〕で表されるアルカリ金属ジフェノラート及び一般式(8)

【0048】 【化12】

$$MO \longrightarrow (A)_{\overline{a}} \longrightarrow 0M \qquad (8)$$

【0049】〔式中A、a及びMは前記に同じ。〕で表されるアルカリ金属ジフェノラートからなる群より選ばれる少なくとも1種のジフェノラートとの混合物を反応させ(第一工程)、次いで得られる化合物に上記アルカリ金属フェノラートを更に反応させる(第二工程)ことにより製造できる。

【0050】上記の製造法において、原料の一つとして使用される、一般式(4)及び一般式(5)で表されるジクロルホスファゼン化合物は、例えば、特開昭57-87427号公報、特公昭58-19604号公報、特公昭61-1363号公報、特公昭62-20124号公報等に記載の公知の方法に従って製造できる。その一例を示せば、まずクロルベンゼン中で、塩化アンモニウムと五塩化リン(又は塩化アンモニウムと三塩化リンと塩素)とを、120~130℃程度で反応させて、脱塩酸することで製造できる。

【0051】一般式(6)で表されるアルカリ金属フェノラートとしては、従来公知のものを広く使用でき、例えばナトリウムフェノラート、カリウムフェノラート、リチウムフェノラート等を挙げることができる。これらアルカリ金属フェノラートは1種を単独で使用でき又は2種以上を併用できる。

【0052】一般式(7)で表されるアルカリ金属ジフェノラートにおいて、2つの基一OM(Mは上記に同じ)は、オルト、メタ又はパラのいずれの位置関係にあってもよい。該アルカリ金属ジフェノラートの具体例としては、例えば、レゾルシノール、ハイドロキノン、カテコール等のアルカリ金属塩を挙げることができる。これらの中でも、ナトリウム塩及びリチウム塩が好ましい。該アルカリ金属ジフェノラートは、1種を単独で使用でき又は2種以上を併用できる。

【0053】一般式(8)で表されるアルカリ金属ジフェノラートとしては、例えば、4,4'ーイソプロピリデンジフェノール(ビスフェノールーA)、4,4'ースルホニルジフェノール(ビスフェノールーS)、4,4'ーチオジフェノール、4,4'ーオキシジフェノール、4,4'ージフェノール等のアルカリ金属塩等を挙げることができる。これらの中でも、ナトリウム塩及びリチウム塩が好ましい。該アルカリ金属ジフェノラートは、1種を単独で使用でき又は2種以上を併用できる。【0054】本発明では、一般式(7)で表されるアルカリ金属ジフェノラート及び一般式(8)で表されるアルカリ金属ジフェノラートをそれぞれ単独で使用してもよいし、これらを混合して使用してもよい。

【0055】上記の製造法の第一工程においては、ジクロルホスファゼン化合物中の塩素原子がアルカリ金属フ

ェノラート及びアルカリ金属ジフェノラートとの反応により全て消費されないように、即ちジクロルホスファゼン化合物中の塩素原子がアルカリ金属フェノラート及びアルカリ金属ジフェノラートとの反応によっても尚残存しているように、アルカリ金属フェノラート及びアルカリ金属ジフェノラートの使用量を調節することが望ましい。これにより、アルカリ金属ジフェノラートの両一〇M基(Mは前記に同じ)がジクロルホスファゼン化合物のリン原子に結合する。第一工程では、アルカリ金属フェノラート及びアルカリ金属ジフェノラートの使用量は、ジクロルホスファゼン化合物の塩素量を基準にして、両フェノラートの合計量で通常0.05~0.9当量程度、好ましくは0.1~0.8当量程度とすればよい。

【0056】上記の製造法の第二工程においては、上記第一工程で生成する化合物中の塩素原子及びフリーの水酸基が全てアルカリ金属フェノラートとの反応によって全て消費されるように、アルカリ金属フェノラートの使用量を調節することが望ましい。本発明では、アルカリ金属フェノラートの使用量は、ジクロルホスファゼン化合物の塩素量を基準にして、通常1~1.5当量程度、好ましくは1~1.2当量程度とすればよい。

【0057】本発明では、アルカリ金属フェノラート (第一工程及び第二工程で用いる合計量)とアルカリ金 属ジフェノラートとの使用割合(アルカリ金属ジフェノ ラート/アルカリ金属フェノラート、モル比)は、通常 1/2000~1/4程度、好ましくは1/20~1/ 6程度とすればよい。

【0058】第一工程及び第二工程の反応は、各々通常室温~150℃程度、好ましくは80~140℃程度の温度下に行われ、通常1~12時間程度、好ましくは3~7時間程度で終了する。第一工程及び第二工程の反応は、いずれも、通常ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素類、モノクロルベンゼン、ジクロルベンゼン等のハロゲン化芳香族炭化水素類等の有機溶媒中にて行われる。

【0059】上記反応により製造される架橋フェノキシホスファゼン化合物は、例えば、洗浄、沪過、乾燥等の通常の単離方法に従い、反応混合物から容易に単離、精製できる。

【0060】該架橋フェノキシホスファゼン化合物は、 分解温度が250~400℃の範囲内にある。

【0061】また、該架橋フェノキシホスファゼン化合物中のフェニル基の含有割合は、一般式(1)の環状フェノキシホスファゼン及び/又は一般式(2)の鎖状フェノキシホスファゼン中の全フェニル基の総数を基準に50~99.9%であり、好ましくは70~90%である

【0062】尚、一般式(2)における末端基X1及び Y1は反応条件等により変化し、通常の反応条件で、例 えば非水の系で温和な反応を行った場合には、 $X^1$ が-N=P(OPh) $_3$ 、 $Y^1$ が-P(OPh) $_4$ の構造となり、水分もしくはアルカリ金属水酸化物が反応系内に存在するような反応条件で又は転移反応が生じるような過酷な反応条件で反応を行った場合には、 $X^1$ が-N=P(O)OPh、 $Y^1$ が-P(O)(OPh) $_2$ の構造のものが混在する状態となる。

【0063】本発明の樹脂組成物において、ホスファゼン化合物の配合量は、芳香族ポリアミド樹脂100重量部に対し、0.1~100重量部、好ましくは1~40重量部とする。0.1重量部未満では、芳香族ポリアミド樹脂にUL規格のV-0に相当する難燃性を付与し得ない場合がある。一方、100重量部を超えて配合した場合、それ以上の難燃性の向上は認められないばかりか、得られる成形物の機械物性等が低下する。

#### 【0064】無機繊維状物質

本発明において、無機繊維状物質としては、繊維状の無 機物質である限り特に制限はなく、従来公知のものを広 く使用することができる。無機繊維状物質としては、具 体的には、繊維状チタン酸アルカリ金属塩、繊維状ホウ 酸遷移金属塩、繊維状ホウ酸アルカリ土類金属塩、繊維 状酸化亜鉛(特公昭60-5529号公報、特公平3-51657号公報等)、繊維状酸化チタン、繊維状酸化 マグネシウム(特開昭60-11223号公報、特開昭 61-210000号公報等)、繊維状石膏(特公昭5 8-12235号公報、特公昭58-34410号公報 等)、繊維状珪酸アルミニウム(特公平4-76956 号公報、特公平7-96480号公報等)、繊維状珪酸 ・カルシウム(特開平8-319199号公報、特開平9 -40840号公報等)、繊維状炭化珪素(特開昭56 -109811号公報、特公平1-4999号公報 等)、繊維状炭化チタン(特公昭59-45638号公 報、特開昭62-250225号公報等)、繊維状窒化 珪素 (特開昭57-17499号公報、特開昭57-1 7500号公報)、繊維状窒化チタン(特開平2-22 1198号公報、特開平7-173000号公報)、炭 素繊維、アルミナ繊維、アルミナーシリカ繊維、ジルコ ニア繊維、ガラス繊維、石英繊維等を挙げることができ

【0065】これら無機繊維状物質の中でも、形状異方性を有するものが好ましい。このような無機繊維状物質としては、具体的には、繊維状チタン酸アルカリ金属塩、繊維状ホウ酸遷移金属塩、繊維状成化チタン、繊維状酸化チタン、繊維状酸化でグネシウム、繊維状石膏、繊維状炭化珪素、繊維状炭化・サタン、繊維状窒化・サタン、繊維状窒化・サタン等の形状異方性を有するものが好ましく、繊維状チタン酸アルカリ金属、繊維状ホウ酸遷移金属塩、繊維状ホウ酸アルカリ金属、繊維状ホウ酸遷移金属塩、繊維状ホウ酸アルカリ土類金属塩、繊維状酸化チタン、繊維状珪酸カルシウ

ム等の形状異方性を有するものが特に好ましい。斯かる無機繊維状物質の中でも、殊に平均繊維径が0.05~2.0μm程度、平均繊維長が1~500μm程度で、アスペクト比(繊維長/繊維径)が通常5以上、好ましくは10以上のものが好適である。

【0066】更に、これらの無機繊維状物質の中でも、pH6.0~9.5のものを使用するのが好ましい。ここで、無機繊維状物質のpHとは、無機繊維状物質の1.0重量%懸濁水(脱イオン水を使用)を10分間撹拌後、20℃で測定したpH値をいう。無機繊維状物質のpHが9.5を大幅に越えると、芳香族ポリアミド樹脂の物性の低下及び耐熱変色性の低下が起る場合があり、好ましくない。一方pHが6.0を極端に下回ると、得られる樹脂組成物の強度の向上効果が低下するのみならず、残留する酸により、加工機械、金型を腐蝕する原因にもなるので、好ましくない。

【0067】これらの無機繊維状物質は、1種を単独で使用でき又は2種以上を併用できる。

【0068】本発明組成物において、無機繊維状物質の配合量は、芳香族ポリアミド樹脂100重量部に対して1~60重量部、好ましくは5~40重量部とする。1重量部未満では、溶融滴下(ドリップ)の防止効果が不十分になる。一方、60重量部を超えると、難燃剤であるホスファゼン化合物の相対的濃度が下がり、得られる樹脂組成物の難燃性が低下する。

#### 【0069】水酸化マグネシウム

本発明においては、水酸化マグネシウムは、架橋ホスファゼン化合物及び無機繊維状物質と共に相乗的に作用して、樹脂成形物が燃焼する際に、樹脂が溶融滴下(ドリップ)するのを防止する効果を発揮する。

【0070】本発明で使用する水酸化マグネシウムとしては、市販品及び合成品のいずれでもよいが、揮発分含量(120℃、1時間)0.01~1重量%、平均粒子径0.1~100 $\mu$ m、比表面積(BET(Brunauer-Emmett-Teller)法)0.1~500 $m^2$ /gのものを使用するのが好ましい。このような水酸化マグネシウムの中でも、揮発分含量0.05~0.5重量%、平均粒子径0.5~30 $\mu$ m、比表面積1~20 $m^2$ /gのものが特に好ましい。尚、平均粒子径は、(株)堀場製作所製の堀場・自然、遠心沈降式、自動粒度分布測定装置「CAPA-300」を使用して測定されたものである。

【0071】揮発分含量が0.01重量%未満では、酸化マグネシウムの副生による難燃性の低下が起こる恐れがある。一方、1重量%を著しく超えると、樹脂との混練時に揮発成分が樹脂の機械物性の低下を引き起こす場合がある。平均粒子径が0.1μmより小さい場合や比表面積が0.1m²/gより小さい場合には、水酸化マグネシウムの取り扱いが難しくなる。一方、平均粒子径が100μmより大きい場合や比表面積が500m²/

gより大きい場合には、樹脂との混練時に分散を充分に 行うことができず、得られる組成物に充分な難燃性を付 与することが困難になる。

【0072】水酸化マグネシウムは、脂肪酸、脂肪酸 塩、シリコン系化合物、エポキシ系化合物等で被覆して もよい。脂肪酸としては、例えばラウリン酸、ミリスチ ン酸、パルミチン酸、ステアリン酸等を挙げることがで きる。脂肪酸塩としては、例えば前記の脂肪酸とナトリ ウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、バリウム 等のアルカリ金属又はアルカリ土類金属との塩等を挙げ ることができる。シリコン系化合物としては、例えばビ ニルトリス (β-メトキシエトキシ) シラン、ビニルト リエトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ケー (メタクリロイルオキシプロピル) トリメトキシシラ ン、アーアミノプロピルトリエトキシシラン等を挙げる ことができる。エポキシ系化合物としては、例えばβ-(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメチル シラン、アーグリシドキシプロピルトリメトキシシラン 等を挙げることができる。

【0073】水酸化マグネシウムの被覆は、公知の方法に従い行うことができる。例えば上記脂肪酸等をメタノール、イソプロピルアルコール、アセトン等の有機溶媒に溶解した後、水酸化マグネシウムを加え、攪拌、混合し、次いで沪過、洗浄後、温風乾燥器中にて乾燥すればよい。水酸化マグネシウムの被覆は、一部被覆及び全面被覆のいずれであってもよいが、全面被覆であるのが望ましい。

【0074】本発明で用いられる水酸化マグネシウムは、例えば協和化学工業(株)から商品名「KISUMA 120、5A、5B、5E及び5J」で、馬居化成工業(株)から商品名「水酸化マグネシウム1、2A及び2B」で、それぞれ市販されている。

【0075】本発明の樹脂組成物において、水酸化マグネシウムの配合量は、芳香族ポリアミド樹脂100重量 部に対して1~60重量部、好ましくは5~40重量部とする。1重量部未満では、樹脂成形物が燃焼する際のドリップを防止効果が不十分になる。一方、60重量部を超えると、得られる樹脂成形物の機械物性が低下す

#### 【0076】<u>その他の添加剤</u>

本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物には、その 好ましい特性を損なわない範囲で、樹脂の難燃化分野に おいて従来から常用される無機充填剤を配合することが できる。このような無機充填剤としては、例えば、水酸 化アルミニウム、硫酸マグネシウム、硫酸カルシウム、 硫酸バリウム、硫酸アルミニウム、硫酸アルミニウムア ンモニウム、硫酸アルミニウムカリウム、硫酸アルミニ ウムナトリウム、炭酸マグネシウム、炭酸カルシウム、 リン酸アルミニウム、リン酸アンモニウム等を挙げるこ とができる。これらの無機充填剤は1種又は2種以上を 使用できる。

【0077】更に本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂 組成物には、その好ましい特性を損なわない範囲で、樹 脂の難燃化分野において従来から常用される無機充填剤 以外の各種添加剤を配合することができる。このような 添加剤としては、例えば、架橋ホスファゼン化合物以外 の難燃剤、紫外線吸収剤、光安定剤、酸化防止剤、遮光 剤、金属不活性剤、消光剤、耐熱安定剤、潤滑剤、離型 剤、着色剤、帯電防止剤、老化防止剤、可塑剤、衝撃強 度改良剤、上記以外の充填剤、相溶化剤等を挙げること ができる。これらの添加剤は1種又は2種以上を適宜組 合せて使用できる。

【0078】 難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物の製造本発明の難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物は、上記必須成分及び必要によりその他の添加剤を公知の方法に従って混合、混練することによって製造できる。例えば、1軸押出機、2軸押出機等の押出機、バンバリーミキサー、加圧ニーダー、2本ロール等の混練機等にて、芳香族ポリアミド樹脂を溶融し、これに架橋ホスファゼン化合物、無機繊維状物質、水酸化マグネシウム及び必要に応じて他の添加剤を加え、混練すればよい。また、芳香族ポリアミド樹脂、無機繊維状物質、水酸化マグネシウム及び必要に応じて他の添加剤をドライブレンドし、得られる混合物を押出機や混練機等で溶融し、これに架橋ホスファゼン化合物を加えて混練してもよい。

【0079】難燃性芳香族ポリアミド樹脂成形体の製造本発明の難燃性樹脂組成物を成形することにより、難燃性樹脂成形体を得ることができる。例えば、射出成形、押出成形(シート押出、異形押出成形を含む)、真空成形、ブロー成形、発泡成形、射出プレス成形、ガス注入成形等の従来公知の成形手段より、樹脂板、シート、フィルム、異形品等の種々の形状の成形品を製造できることは勿論であり、また共押出混練機等を用いて、二層乃至三層構造の樹脂板を製造することも可能である。

# 【0080】<u>難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物及び成</u>形体の用途

このようにして得られる本発明の難燃性樹脂組成物及び 難燃性樹脂成形体は、電気・電子・通信、農林水産、鉱 業、建設、食品、繊維、衣類、医療、石炭、石油、ゴ ム、皮革、自動車、精密機器、木材、家具、印刷、楽器 等の幅広い産業分野に使用できる。

【0081】より具体的には、本発明の難燃性樹脂組成物及び難燃性樹脂成形体は、プリンター、パソコン、ワープロ、キーボード、PDA(小型情報端末機)、電話機、ファクシミリ、複写機、ECR(電子式金銭登録機)、電卓、電子手帳、電子辞書、カード、ホルダー、文具等の事務・OA機器、洗濯機、冷蔵庫、掃除機、電子レンジ、照明器具、ゲーム機、アイロン、炬燵等の家電機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジカセ、テープレコーダー、ミニディスク、CDプレイヤー、MD

プレイヤー、スピーカー、液晶ディスプレイ等のAV機器、コネクター、リレー、コンデンサー、スイッチ、プリント基板、コイルボビン、半導体封止材料、電線、ケーブル、トランス、偏向ヨーク、分電盤、時計等の電気・電子部品及び通信機器等の用途に使用される。

【0082】また、本発明の難燃性樹脂組成物及び難燃性樹脂成形体は、座席(詰物、表地等)、ベルト、天井張り、コンパーチブルトップ、アームレスト、ドアトリム、リアパッケージトレイ、カーペット、マット、サンバイザー、ホイルカバー、マットレスカバー、エアバック、絶縁材、吊り手、吊り手帯、電線被服材、電気絶縁材、塗料、コーティング材、上張り材、床材、隅壁、デッキパネル、カバー類、合板、天井板、仕切り板、屋壁、カーペット、壁紙、壁装材、外装材、内装材、屋根材、防音板、断熱板、窓材等の自動車、車両、船舶、航空機及び建築用材料や、衣類、カーテン、シーツ、赤ーを機及び建築用材料や、衣類、カーテン、シーツ、赤ーな、合繊板、絨毯、玄関マット、シート、バケツ、ホース、容器、眼鏡、鞄、ケース、ゴーグル、スキー板、ラケット、テント、楽器等の生活・スポーツ用品の各種用途に使用される。

#### [0083]

【実施例】以下に合成例、参考例、実施例、比較例及び 試験例を挙げ、本発明を更に詳しく説明する。以下において、「部」及び「%」とあるのは、それぞれ「重量 部」及び「重量%」を意味する。また、「-Ph」及び 「-Ph-」とあるのは、それぞれ「フェニル基」及び 「フェニレン基」を意味する。

【0084】合成例1(p-フェニレン基による架橋構造を有するフェノキシホスファゼン化合物の合成)フェノール103.5g(1.1モル)、水酸化ナトリウム44.0g(1.1モル)、水50g及びトルエン500mlの混合物を加熱還流し、水のみを系外に取り除くことにより、ナトリウムフェノラートのトルエン溶液を調製した。

【0085】前記反応と並行し、2リットル四つロフラスコにハイドロキノン16.5g(0.15モル)、フェノール94.1g(1.0モル)、水酸化リチウム31.1g(1.3モル)、水52g及びトルエン600m1を入れ、この混合物を加熱還流し、水のみを系外に取り除くことにより、ハイドロキノンとフェノールのリチウム塩のトルエン溶液を調製した。このトルエン溶液に、ジクロルホスファゼンオリゴマー(3量体62%、4量体12%、5量体及び6量体11%、7量体3%、8量体以上12%の混合体)1.0ユニットモル(115.9g)を含む20%クロルベンゼン溶液580gを、撹拌下30℃以下で滴下した後、110℃で3時間撹拌した。次に、この反応液に、先に調製したナトリウムフェノラートのトルエン溶液を撹拌下で添加した後、撹拌下に110℃で4時間反応を継続した。

【0086】反応終了後、反応混合物を3%水酸化ナト

リウム水溶液1.0リットルで3回洗浄し、次に、水1.0リットルで3回洗浄した後、有機層を減圧下で濃縮した。得られた濃縮物を80℃、400Paの圧力下に11時間加熱真空乾燥し、架橋フェノキシホスファゼンの微黄色粉末211gを得た。

【0087】上記で得られた架橋フェノキシホスファゼンは、加水分解塩素0.04%、重量平均分子量(Mw)1100(ポリスチレン換算、GPC分析)であり、リン含有率及びCHN元素分析値よる組成は、ほぼ  $[N=P(-O-p-Ph-O-)_{0.15}(-O-Ph)_{1.7}]$  であることが判明した。

【0088】 TG/DTA分析 (熱重量分析) では明確な融点は示さず、分解開始温度は306℃、5%重量減少温度は311℃であった。

【0089】また、アセチル化法によって残存水酸基の 定量を行った結果、検出限界(サンプル1g当りのヒド ロキシ当量として1×10<sup>-6</sup>当量/g)以下であった。 【0090】参考例1

比較例で使用する、ハロゲンを含まないリン酸エステル系難燃剤、レゾルシノールービス(ジフェニルホスフェート):  $(C_6 H_5 O)_2 P(=O) O C_6 H_4 O P(=O) (C_6 H_5 O)_2$ ] を次のようにして合成した。

【0091】2リットル四つロフラスコに、フェノール180.5g(1.92モル)、塩化マグネシウム1.4g(0.02モル)及びキシレン19.2gを入れ、加熱混合した。反応液の温度が120℃に達した時点で、反応液にオキシ塩化リン147.2g(1.0モル)を約2時間かけて添加した。この際に発生する塩酸ガスは水スクラバーへ導いた。オキシ塩化リンの添加終了後、反応液の温度を2時間かけて徐々に180℃まで昇温し、反応を完結した。

【0092】この反応液に、レゾルシン52.8g (0.53モル)及び塩化アルミニウム1.4g(0.01モル)を加えて加熱混合し、反応温度を2時間かけて徐々に180℃まで昇温した。更に同温度にて2時間撹拌後、26700Paの減圧下に更に2時間撹拌を行い、反応を完結した。

【0093】得られた反応混合物にキシレン330g及び10%塩酸33gを添加し、撹拌して残存する触媒を除去し、更に4%食塩水99gで洗浄した。得られた有機層から、減圧下でキシレンを除去し、目的化合物を油状物として得た。収率99.2%。

【0094】合成例2(2,2'-ビス(p-オキシフェニル)イソプロピリデン基による架橋構造を有するフェノキシホスファゼンの合成)

フェノール65.9g(0.7モル)及びトルエン500m1を1リットル四つロフラスコに入れ、撹拌下、内部の液温を25℃に保ちつつ、金属ナトリウム0.65グラム原子14.9gを細かく裁断して投入した。投入終了後77~113℃で金属ナトリウムが完全に消失す

るまで8時間撹拌を続けた。

【0095】前記反応と並行し、ビスフェノールーA 57. 1g(0.25モル)、フェノール103.5g (1.1モル)及びテトラヒドロフラン (THF)80 0m1を3リットル四つ口フラスコに入れ、撹拌下、内 部の液温を25℃に保ちつつ、金属リチウム1.6グラ ム原子11.1gを細かく裁断して投入した。投入終了 後61~68℃で金属リチウムが完全に消失するまで8 時間撹拌を続けた。このスラリー溶液にジクロルホスフ ァゼンオリゴマー (3量体75%、4量体17%、5量 体及び6量体6%、7量体1%、8量体以上1%の混合 体) 1. 0ユニットモル (115.9g) を含む37% クロルベンゼン溶液313gを撹拌下、内部の液温を2 0℃以下に保ちつつ1時間かけて滴下した後、80℃で 2時間攪拌した。次いで撹拌下、内部の液温を20℃に 保ちつつ、別途調製したナトリウムフェノラート溶液を 1時間かけて添加した後、80℃で5時間撹拌した。 【0096】反応終了後、反応混合物を濃縮してTHF を除去し、新たにトルエン1リットルを添加した。この トルエン溶液を2%NaOH 1リットルで3回洗浄 し、次に水1リットルで3回洗浄した後、有機層を減圧 下に濃縮した。得られた生成物を80℃、400Pa以 下で11時間加熱真空乾燥して、架橋フェノキシホスフ ァゼンの白色粉末229gを得た。

【0097】上記で得られた架橋フェノキシホスファゼンは、加水分解塩素O.07%、重量平均分子量(Mw)1130(ポリスチレン換算)であり、機含有率及びCHN元素分析値により、組成はほぼ  $[N=P(-O-Ph-C(CH_3)_2-Ph-O-)_{0.25}(-O-Ph)_{1.50}]$ と決定した。

TG/DTA分析:明確な融点は示さず、分解開始温度:308℃、5%重量減少温度:313℃ 残存水酸基量:検出限界(サンプル1g当りのヒドロキシ当量として1×10-6当量/g)以下(アセチル化法)

【0098】合成例3(4,4'-スルホニルジフェニレン基(ビスフェノールーS残基)による架橋構造を有するフェノキシホスファゼンの合成)

フェノール103.5g(1.1モル)及びTHF 5 00mlを1リットル四つロフラスコに入れ、撹拌下、 内部の液温を25℃に保ちつつ、金属ナトリウム1.1 グラム原子25.3gを細かく裁断して投入した。投入 終了後65~72℃で金属ナトリウムが完全に消失する まで5時間撹拌を続けた。

【0099】前記反応と並行し、1リットル四つロフラスコ中で、フェノール94.1g(1.0モル)及びビスフェノールーS 87.5g(0.35モル)をTHF500mlに溶解し、この溶液に25℃以下で金属ナトリウム1.05g原子の砕片24.1gを投入し、投入終了後1時間かけて61℃まで昇温し、更に61~6

8℃で6時間撹拌を続け、ナトリウムフェノラート溶液 を調製した。この溶液をジクロルホスファゼンオリゴマ - (3量体62%、4量体12%、5量体及び6量体1 1%、7量体3%、8量体以上12%の混合体)1.0 ユニットモル(115.9g)を含む20%クロルベン ゼン溶液580gに、25℃以下の冷却・撹拌下で滴下 後、71~73℃で3時間撹拌した。次に、この反応液 に、先に調製したナトリウムフェノラート溶液を滴下し た後、撹拌下に71~73℃で3時間反応を継続した。 【0100】反応終了後、反応混合物を濃縮し、濃縮物 をクロルベンゼン500mlに再溶解した後、5%Na OH水洗浄を3回、5%硫酸洗浄を1回、5%重曹水洗 浄を1回、水洗を3回行った後、洗浄液を濃縮乾固し、 架橋フェノキシホスファゼンの淡黄色粉末216gを得 た。

【0101】上記で得られた架橋フェノキシホスファゼ ンは、加水分解塩素 0.05%、重量平均分子量(M w)1030(ポリスチレン換算)であり、燃含有率及 びCHN元素分析値により、組成はほぼ [N=P(-O  $-Ph-SO_2-Ph-O-)_{0.25}$  (-O-P h)<sub>1.50</sub>]と決定した。

TG/DTA分析;融解温度Tm:103℃、分解開始 温度:321℃、5%重量減少温度:332℃ 残存水酸基量:検出限界(サンプル1g当りのヒドロキ シ当量として1×10-6当量/g)以下(アセチル化

【0102】合成例4([-HN-p-Ph-CH<sub>2</sub>p-Ph-NH-OC-(CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>-CO-]の繰り返 し単位を有する芳香族ポリアミドの合成)

窒素導入管及び減圧用コック付きオートクレーブ中で、 4, 4'-ジアミノジフェニルメタン991g(5.0 モル)とセバシン酸1062g(5.25モル)との混 合物を、窒素気流下285℃に加熱し、溶融した。次い で、オートクレーブの内部圧を1333Paに減圧し、 更に溶融状態を1時間保持した後、再び窒素気流下、常 圧常温まで冷却し、目的の芳香族ポリアミドを製造し

【0103】得られた芳香族ポリアミドの固有粘度は 0.70~0.92d1/gであった(5%の塩化リチ ウムを含むN, Nージメチルアセトアミド中、O. 5g /dlの濃度、30℃で測定)。

【0104】合成例5([-HN-(CH<sub>2</sub>)<sub>6</sub>-NH-OC-p-Ph-CO-]の繰り返し単位を有する芳香 族ポリアミドの合成)

4.4'ージアミノジフェニルメタン及びセバシン酸に 代えて、同モル量のヘキサメチレンジアミン及びテレフ タル酸を用いる以外は、合成例4と同様に操作し、目的 の芳香族ポリアミドを製造した。

【0105】得られた芳香族ポリアミドの固有粘度は 0.69~0.87dl/gであった(5%の塩化リチ ウムを含むN, N-ジメチルアセトアミド中、O.5g /dlの濃度、30℃で測定)。

【0106】合成例6([-HN-(CH<sub>2</sub>)<sub>6</sub>-NH-OC-m-Ph-CO-]の繰り返し単位を有する芳香 族ポリアミドの合成)

テレフタル酸に代えて同モル量のイソフタル酸を使用す る以外は、合成例5と同様に操作し、目的の芳香族ポリ アミドを製造した。

【0107】得られた芳香族ポリアミドの固有粘度は 0.65~0、84d1/gであった(5%の塩化リチ ウムを含むN, N-ジメチルアセトアミド中、0.5g /dlの濃度、30℃で測定)。

【0108】合成例7([(-OC-p-Ph-NH  $-)_{0.6} (-OC-m-Ph-COO-(CH_2)_2-O$ 一)0.4]の繰り返し単位を有する芳香族ポリアミドの 合成)

p-アセトアミド安息香酸895g(5.0モル)とポ リ(エチレンイソフタレート)(固有粘度〇.56)6 40g(3.33モル)との混合物を20メッシュ以下 の粒状に粉砕し、得られる粉砕物を減圧コック付きオー トクレーブに入れ、13.3Paの減圧下で、180℃ で1時間、220℃で3時間、230℃で10時間加熱 した後、室温まで冷却し、目的の芳香族ポリアミドを製

【0109】得られた芳香族ポリアミドの固有粘度は 0.57~0.68d1/gであった(フェノール/テ トラクロロエタン=60/40(v/v)の混合溶媒 中、0.5g/d1の濃度、25℃で測定)。

【0110】実施例1

合成例4で得られた芳香族ポリアミド樹脂100部を熱 風循環式乾燥器(タバイエスペック(株)製の Perfect Oven Original-PH200) にて120℃で12時間乾燥し た後、これに無機繊維状物質10部及び水酸化マグネシ ウム10部を混合した。この混合物を粉体供給機(商品 名: Accurate-Model-100、(株) クラマエンジニアリン グ製)より二軸押出機(商品名: S1-KRC, 25mmニー ダー、栗本鉄工所(株)製)に供給し、スクリュー温度 240~270℃で混練、溶融した後、スクリュー中央 部分より難燃剤(架橋ホスファゼン化合物)15部又は 20部を添加し、更に混練、溶融した。得られた溶融物 をペレタイザー(商品名: Model-C-3、エンプラ産業 (株)製)に供給し、12種の本発明難燃性芳香族ポリ

アミド樹脂組成物のペレットを製造した。より具体的な 組成を下記表1に示す。

【0111】尚、架橋ホスファゼン化合物としては合成 例1~3で得られた架橋ホスファゼン化合物を用いた。 また、無機繊維状物質及び水酸化マグネシウムとして は、次のものを用いた。

【0112】繊維状チタン酸カリウム:商品名「ティス モN-102」、大塚化学(株)製、平均繊維径0.4 μm、平均繊維長15μm、アスペクト比10以上、p H9. 5、以下「TISMO」という。

【0113】繊維状珪酸カルシウム:商品名「バイスタル」、大塚化学(株)製、平均繊維径0.4μm、平均繊維長28μm、アスペクト比7以上、pH9.5、以下「WN」という。

【0114】繊維状ホウ酸マグネシウム:商品名「PGM」、大塚化学(株)製、平均繊維径 $0.4\mu$ m、平均繊維長 $15\mu$ m、アスペクト比10以上、pH9.0、以下「PGM」という。

【0115】水酸化マグネシウム: 商品名「KISUMA 120」、協和化学工業(株)製、揮発分含量(1

20℃·1時間)0.1%、平均粒子径1.0μm、比表面積(BET法)5m²/g、粒子表面無被覆品。 【0116】比較例1

無機繊維状物質又は水酸化マグネシウムを使用しないか、或いは架橋ホスファゼン化合物に代えて参考例1で得られたレゾルシノールービス(ジフェニルホスフェート)を使用する以外は、実施例1と同様に操作し、5種の芳香族ポリアミド樹脂組成物のペレットを製造した。より具体的な組成を下記表1に示す。

[0117]

【表1】

	No.	芳香族ポリアミド	雞 燃 剤	無機鐵維状物質	水酸化マグネシウム
		(配合量、部)	(配合登、部)	(配合量、部)	配合量、部
	1	合成例4(100)	合成例1 (20)	TISMO (10)	1 0
	2	合成例4(100)	合成例1 (15)	TISMO (10)	1 0
寒	3	合成例 4 (100)	合成例2 (20)	TISMO (10)	10
	4	合成例4(100)	合成例3 (20)	TISMO (10)	· 10
施	5	合成例4(100)	合成例1 (20)	WN (10)	1 0
	6	合成例4(100)	合成例2 (20)	WN (10)	10
例	7	合成例4(100)	合成例2 (15)	WN (10)	10
1	8	合成例4(100)	合成例3 (20)	WN (10)	10
1	9	合成例 4 (100)	合成例1 (20)	PGM (10)	10
1	10	合成例 4 (100)	合成例2 (20)	PGM (10)	1 0
	11	合成例4(100)	合成例3 (20)	PGM (10)	10
L	12	合成例 4 (100)	合成例3 (15)	PGM (10)	10
比	1	合成例 4 (100)	合成例1 (20)	_	1 0
較	2	合成例 4 (100)	合成例1 (20)	WN (10)	0
Ø	3	合成例 4 (100)	参考例1 (20)	TISMO (10)	1 0
1	4	合成例 4 (100)	参考例1 (20)	WN (10)	10
L	5	合成例 4 (100)	参考例1 (20)	PGM (10)	10

#### 【0118】実施例2~4

芳香族ポリアミドとして、合成例4で得られた芳香族ポリアミドに代えて合成例5で得られた芳香族ポリアミド(実施例2)、合成例6で得られた芳香族ポリアミド(実施例3)又は合成例7で得られた芳香族ポリアミド(実施例4)を使用する以外は、実施例1と同様にして、各実施例につき各々12種の本発明難燃性ポリアミド樹脂組成物のペレットを製造した。

# 【0119】比較例2~4

芳香族ポリアミドとして、合成例4で得られた芳香族ポリアミドに代えて合成例5で得られた芳香族ポリアミド(比較例2)、合成例6で得られた芳香族ポリアミド(比較例3)又は合成例7で得られた芳香族ポリアミド(比較例4)を使用する以外は、比較例1と同様にして、各比較例につき各々5種のポリアミド樹脂組成物のペレットを製造した。

## 【0120】試験例1

実施例1~4及び比較例1~4で得られた各ポリアミド 樹脂組成物のペレットについて、下記の試験を実施し た。

【0121】1. 難燃性試験: UL-94の試験法 (Te st for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances UL94, Fourt h Edition) に基づき、厚さ1/16インチ、長さ5イ

ンチ、幅0.5インチの試験片(ペレットからの試験片の作成は、下記5.の加工性のところで述べるのと同じ条件下に行った)を用いて評価試験を実施した。評価基準を以下に示す。

【0122】V-0:下記(A)~(E)の条件を全て 満たす。

- (A) 1セット5個のどの試験片も接炎後のフレイミング(炎をあげて燃え続ける)は10秒以下。
- (B) 1セット5個の試験片に2回ずつ、合計10回の接炎後のフレイミング合計は50秒以内。
- (C) 1セット5個のどの試験片もクランプまでフレイミングしない。
- (D) 1セット5個のどの試験片も305mm下の綿を 発火するフレイミング粒を滴下しない。
- (E) 1セット5個のどの試験片も2回目の接炎後、グローイング (残じん:炎をあげて燃えないが、赤熱した 火種として残る)は30秒以内。
- 【0123】V−1:下記(A)~(E)の条件を全て 満たす。
- (A) 1セット5個のどの試験片も接炎後のフレイミングは30秒以内。
- (B) 1セット5個の試験片に2回ずつ、合計10回の 接炎後のフレイミング合計は250秒以内。
- (C)及び(D)はV-0に同じ。

(E) 1 セット 5 個のどの試験片も 2 回目の接炎後、グローイングは 6 0 秒以内。

【0124】V-2:下記(A)~(E)の条件を全て満たす。

(A) (B) (C) (E) はV-1に同じ。

(D) 1セット5個の試験片のうち一つ以上が305mm下の綿を発火するフレイミング粒を滴下する。

【0125】HB:水平試験で1セット3個のどの試験 片も接炎後101.6mm標線まで燃えない。

【0126】 2. 平均燃焼時間: 1セット5個の試験片を接炎2回、合計10回接炎後のフレイミングの合計時間を10で除した値を平均燃焼時間とした。

【0127】 3. ドリップの有無:上記1. の難燃性試験時、綿を発火するフレイミング粒 (ドリップ) の有無を目視で判定した。

【0128】 4. 溶融混練押出状態: 難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物の溶融混練押出し時の状態を観察し、次の基準で判定した。

良好;ストランドが安定して一定の太さで引ける。

不良; ストランドが不安定で、引き取り時に太さが変化し、折れ易く、しばしば切断する。

【0129】5.加工性:難燃性芳香族ポリアミド樹脂 組成物のペレットを熱風循環式乾燥器中にて120℃で 12時間乾燥した後、射出成形機(商品名:MINIMAT-26 /15B、住友重機械工業(株)製)を用い、シリンダー温 度220~280℃、金型温度50~90℃で、上記

1. 難燃性試験の試験片を射出成形する際の状態を観察し、次の基準で判定した。

良好;ペレットを容易に供給でき、得られる試験片の表面が安定して滑らかである。

不良;ペレットが供給スクリューで滑り易く、得られる 試験片の表面が荒れている。

【0130】6.色相:添加剤を配合しない樹脂を基準にして目視により判定した。

【0131】結果を表2~表5に示す。

[0132]

【表2】

		腱	燃	性	館	成	形	加 工	性	鮑
	No.	難燃性	平均	&焼	ドリップ	混練	押出	試験片	試	负片
1			時間	(秒)	の有無	状	態	加工性	色	相
Г	1	V-0	2.	0	無	良	好	良好	薄黄	白色
1	2	V-0	5.	1	無	良	好	良好	薄黄	白色
実	3	V-0	4.	0	無	良		良好	薄黄	白色
1	4	V-0	3.	1	無	良	好	良好	灰	色
施	5	V-0	5.	0	無	良	好	良好	灰	色
	6	V-0	3.	6	無	良	好	良好	厌	色
例	7	V-0	8.	1	無	良	好	良好	薄黄	白色
	8	V-0	4.	. 4	無	良	好	良好	薄黄	白色
1	9	V-0	1.	. 0	無	良	好	良好	遊	白色
1	10	V-0	1.	. 5	無	良	好	良好	薄黄	白色
	11	V-0	1.	. 0	無	良	好	良好	荐员	白色
1	12	V-0	7.	. 7	無	良	好	良好	薄黄	白色
比	1	HB		-	有	不	良	不良	灰	色
較	2	HB	ΓΤ		有	不	良	不良	灰	色
91	3	V-2	8	. 2	有	不	良	不良	灰	色
1	4	V-2	6	. 9	有	不	良	不良	灰	色
ı	5	V-2	111	. 0	有	一不	良	不良	ヌ	色

[0133]

ľ	弗	3	1
L	3℃	_	

	_	難	燃	性	能	成	形	加工	性	能
	No.	雜燃性	平均燃	_=	ドリップ	_		試験片		计
		~~~		₩)	の有無	状	加	加工性	色	相
-	1	V-0	5.	0	無	良	好	良好	灰	色
	2	V-0	6.	3	無	良	好	良好	薄黄	白色
奥	3	V-0	1.	0	無	良	好	良好	育黄	白色
	4	V-0	1.	5	無。	良	好	良好	薄黄	白色
施	5	V-0	4.	0	無	良	好	良好	薄黄	白色
	6	V-0	3.	6	無	良	好	良好	灰	色
49	7	V-0	5.	9	無	艮	好	良好	薄黄	白色
1	8	V-0	4.	4	無	良	好	良好	灰	色
2	9	V-0	1.	0	無	良	好	良好	特黄	白色
1	10	V-0	1.	5	無	良	好	良好	養苗	白色
	11	V-0	1.	9	無	良	好	良好	符贯	白色
1	12	V-0	9.	5	無	艮	好	良好	薄黄	白色
比	1	HB	_	,	有	下	良	不良	灰	色
較	2	V-2	19.	2	有	不	良	不良	灰	色
91	3	V-2	9.	9	有	不	良	不良	灰	色
2	4	V-2	7.	0	有	不	良	不良	灰	色
	5	V-2	18.	5	有	不	良	不良	灰	色

[0134]

【表4】

		凝	燃	性	饄	成	形	加工	性	能
	No.	嶷燃性	平均	战烧	ドリップ	起網	押出	試験片	試Ⅰ	9 片
			時間	(秒)	の有無	状	鰒	加工性	色	相
	1	V-0	3.	6	無	良	好	良好	薄黄	白色
	2	V - 0	6.	4	無	良	好	良好	灰	囹
寒	3	V - 0	4.	9	無	良	好	良好	薄黄	白色
1	4	V ~ 0	2.	4	無	良	好	良好	灰	色
施	5	V - 0	5.	1	無	良	好	良好	灰	色
1	6	V-0	3.	3	無	良	好	良好	灰	色
例	7	V-0	8.	0	無	良	好	良好	灰	色
	8	V-0	4.	_1	無	良	好	良好	民	色
3	9	V - 0	2.	2	無	良	好	良好	灰	色
	10	V-0	3.	0	無	良	好	良好	灰	色
1	11	V-0	2.	1	無	良	好	良好	薄黄	白色
1.	12	V-0	9.	1	無	良	好	良好	薄黄	白色
进	1	HB		-	有	不	良	不良	灰	色
較	2	V - 2	15.	0	有	不	良	不良	灰	色
例	3	V-2	12.	. 3	有	不	良	不良	灰	色
3	4	V-2	10.	1	有	不	良	不良	灰	色
	5	V-2	13.	2	有	不	良	不良	灰	色

[0135]

【表5】

		雞	燃性	能	成形	加工	性能
	No.	難燃性	平均燃烧	ドリップ	混練押出	試験片	試験片
			時間(秒)	の有無	状態	加工性	色相
	1	V-0	2.8	無	良好	良好	薄黄白色
	2	V - 0	8. 1	無	良好	良好	育黄白色
寒	3	V-0	3. 5	無	良好	良好	筹黄白色
	4	V-0	6.0	無	良好	良好	薄黄白色
施	5	V-0	4. 9	無	良好	良好	薄黄白色
	6	V-0	3. 7	無	良好	良好	灰色
例	7	V-0	7.4	無	良好	良好	薄黄白色
	8	V-0	5.1	無	良好	良好	灰色
4	9	V-0	2. 1	無	良好	良好	灰色
	10	V-0	1.6	無	良好	良好	灰色
	11	V-0	1.2	無	良好	良好	<b>萨黄白色</b>
	12	V-0	6.0	無	良好	良好	薄黄白色
比	1	НВ	_	有	不良	不良	灰色
較	2	HB	-	有	不 良	不良	灰色
例	3	V-2	9.0	有	不良	不良	灰色
4	4	V-2	7.6	有	不良	不良	灰色
	5	V - 2	18.8	有	不良	不良	灰色

# 【手続補正書】

【提出日】平成12年7月10日(2000.7.1 0)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

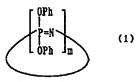
【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (a) 芳香族ポリアミド樹脂100重量

部に、(b)<u>一般式(1)</u>

【化1】



〔式中mは3~25の整数を示す。Phはフェニル基を 示す。〕で表される環状フェノキシホスファゼン及び一 般式(2)

【化2】

$$X^{1} = \begin{cases} Ph \\ P=N \\ OPh \end{cases} Y^{1}$$
 (2)

〔式中X1は基-N=P(OPh)3又は基-N=P(O)O

Phを示し、Y1は基-P(OPh)。又は基-P(O)(OPh)。を示す。nは3~1000の整数を示す。Phは前記に同じ。)で表される鎖状フェノキシホスファゼンからなる群より選ばれる少なくとも1種のホスファゼン化合物が、o-フェニレン基、m-フェニレン基、p-フェニレン基及び一般式(3) 【化3】

【式中Aは-C(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>-、-SO<sub>2</sub>-、-S-又は-O-を示す。aはO又は1を示す。〕で表されるビスフェニレン基からなる群より選ばれる少なくとも1種の架橋基により架橋されてなる化合物であって、(i)該架橋基はホスファゼン化合物のフェニル基が脱離した2個の酸素原子間に介在し、(ii)フェニル基の含有割合が上記ホスファゼン化合物(1)及び/又は(2)中の全フェニル基の総数を基準に50~99.9%であり、且

つ(iii)分子内にフリーの水酸基を有していない架橋フェノキシホスファゼン化合物0.1~100重量部、(c)無機繊維状物質1~60重量部及び(d)水酸化マグネシウム1~60重量部を配合してなる難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物。

【請求項2】 無機繊維状物質が、繊維状チタン酸アルカリ金属塩、繊維状ホウ酸遷移金属塩、繊維状ホウ酸アルカリ土類金属塩、繊維状酸化亜鉛、繊維状酸化チタン、繊維状酸化マグネシウム、繊維状石膏、繊維状芽酸アルミニウム、繊維状珪酸カルシウム、繊維状炭化珪素、繊維状炭化チタン、炭素繊維、アルミナ繊維、アルミナーシリカ繊維、ジルコニア繊維、ガラス繊維及び石英繊維から選ばれる少なくとも1種である請求項1に記載の難燃性芳香族ポリアミド樹脂組成物。

【請求項3】 請求項1 又は請求項2 に記載の難燃性ポリアミド樹脂組成物を成形して得ることのできる難燃性 芳香族ポリアミド樹脂成形体。

#### フロントページの続き

(72)発明者 亀島 隆

德島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化 学株式会社徳島研究所内

学株式会社徳島研究所内

(72)発明者 西岡 洋一

德島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化

学株式会社徳島研究所内

(72)発明者 高瀬 裕行

徳島県徳島市川内町加賀須野463 大塚化

学株式会社徳島研究所内

Fターム(参考) 4J002 CL031 CL061 CL081 CM021

CM031 CM041 CN051 CN061

CQ012 DA016 DB016 DE076

DE077 DE096 DE106 DE136

DE146 DE186 DF016 DG056

DJ006 DJ016 DK006 DL006

FA046 FB107 FB137 FB147

FB237 FD016 FD132 FD137